第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）を取り巻く経済環境は、一昨年来の米国におけるバブルの崩壊とその後の事態の深刻化、及び世界的なデフレ傾向を背景として、株式の低迷、個人消費の伸び悩み、企業のＩＴ投資の抑制傾向が続きました。これに加え、中国などの生産能力の向上により価格競争が激化するなど、ＩＴ産業を取り巻く市場は急激な構造変化が進行し、景況は年間を通して非常に厳しく推移いたしました。一方で国内ではe-Japan計画の波及効果が続き、年度後半から海外でも中国などのアジア市場が回復、欧米を中心とした通信事業会社の投資底入れの兆候なども出てきましたが、年度末にかけてイラク問題等の国際情勢の緊迫化やＳＡＲＳの影響等により全世界的に景気の先行きに対する不透明感が高まりました。

当連結会計年度は、携帯電話、半導体、ＰＤＰなどの売上は増えたものの、光伝送システム、サーバなどのプラットフォーム製品の売上が大幅に減少し、ソフトウェア・サービスビジネスの売上も伸び悩みました。また、前年度下半期においてデスクトップパソコン向け小型磁気ディスク装置ビジネスから撤退したこともあり、全体の売上高は４兆6,175億円（前年度比８％減）となりました。

損益につきましては、前年度及び当年度に実施しました構造改革によるスリム化の効果、さらに徹底したコスト削減努力により、営業利益は1,004億円（前年度は744億円の営業損失）、経常利益は123億円（同1,571億円の経常損失）となり、売上が減少するなか、利益を大幅に改善いたしました。一方では、ＩＴ市場の構造変化とデフレの進行に対応して事業構造改善費用1,514億円、小型磁気ディスク装置の不具合対策費用306億円を計上したほか、株式市場の低迷により保有株式の評価損を計上し、当期純損失は1,220億円（同3,825億円の当期純損失）となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

1.事業の種類別セグメント

a.ソフトウェア・サービス

当連結会計年度のソフトウェア・サービスビジネスの売上高は、国内は１兆5,068億円（前年度比1.8%減）（国内向け受注高：１兆607億円［前年度比4.7%減］、当社単独ベース）、海外は5,189億円（前年度比5.9%減）となり、全体では２兆257億円（同2.9%減）となりました。

ソフトウェア・サービスビジネスでは、ＩＴ投資全般が落ち込むなか、e-Japan計画の波及効果が進む医療分野、グローバル展開の進む製造業向けなどで売上を拡大、また、ブロードバンドネットワークインフラの普及に伴い、企業向けアウトソーシングサービスが順調に伸長いたしましたが、一方日米欧での通信事業会社の投資抑制、また金融機関の大口需要の一巡の影響を強く受けました。

利益面では、海外における事業構造改革の進展により英米の拠点が利益体質に転換、またソリューションのパッケージ化、ＥＪＢ部品化技術の適用本格化により事業効率を改善し、売上が減少するなかで営業利益は1,765億円（同11.8%増）となりました。

b.プラットフォーム

当連結会計年度のプラットフォームビジネスの売上高は、国内は１兆1,599億円（前年度比14.8%減）（国内向け受注高：１兆1,682億円［前年度比10.7%減］、当社単独ベース）、海外は4,521億円（前年度比30.9%減）（海外向け受注高：2,274億円［前年度比28.9%減］、当社単独ベース）となり、全体では１兆6,120億円（前年度比20.0%減）となりました。

プラットフォームビジネスでは、パソコンが、国内市場全体の出荷台数が前年を下回り価格競争が激しくなるなか、個人向けを中心としてシェアを伸ばし、携帯電話では当社独自仕様の、誰でも簡単に使えるタイプの機種の販売が好調でした。

一方、北米だけでなく国内でも通信事業会社の深刻な投資抑制が引き続いたことにより、光伝送システムの売上が前年度比で大幅に減少したほか、国内の３Ｇ対応モバイルシステムの売上も伸び悩みました。また、大型サーバ、ストレージシステムの売上が、金融分野の投資の一巡により大きく減少したことに加え、デスクトップパソコン向け小型磁気ディスク装置ビジネスからの撤退の影響もあり、売上高が大幅に減少いたし

ました。
　利益面では、当年度も徹底した事業のスリム化を実現するために事業構造改革を実施し、さらにコストダウン・費用効率化を進めました。この結果、営業利益は９億円（前年度は575億円の営業損失）と益転し、大幅に改善いたしました。

c.電子デバイス
　当連結会計年度の電子デバイスビジネスの売上高は、国内は2,996億円（前年度比13.8%増）（国内向け受注高：1,817億円［前年度比15.8%増］、当社単独ベース）、海外は3,190億円（前年度比12.6%増）（海外向け受注高：517億円［前年度比19.5%減］、当社単独ベース）、全体では6,186億円（前年度比13.2%増）（半導体ワールドワイド生産高3,983億円［前年度比0.1%増］）となりました。
　半導体分野では、ディジタルＡＶ機器、携帯電話向けを中心に在庫調整が一巡したため、売上高はロジックＩＣ、フラッシュメモリともに前年度と比べ大きく増加いたしました。また、ＰＤＰ、コンポーネントなどのすべての分野で売上高は前年度を上回りました。
　損益面では、フラッシュメモリなどの価格面での回復は進まないものの半導体市況は底入れし、プラズマテレビの需要本格化によりＰＤＰ事業の収益が大きく改善、また事業構造改革に取り組んだことによるスリム化の効果もあり、損益は大幅に改善しておりますが、営業利益は316億円の損失（前年度は1,093億円の営業損失）となりました。

d.金融
　当連結会計年度の金融の売上高は1,192億円（前年度比4.2%増）、営業利益は43億円（同2.4%）となりました。

e.その他
　当連結会計年度のその他の売上高は、国内は1,950億円（前年度比4.0%増）、海外は468億円（同18.2%減）、全体では2,418億円（同1.2%減）となりました。営業利益は100億円（同39.0倍）となりました。

　なお、当連結会計年度に行った事業の種類別セグメントの区分の見直しに伴い、前年度のセグメント区分を組み替えて比較を行っております。

2.所在地別セグメント
a.日本
　当連結会計年度の日本における売上高は、アウトソーシングサービスや携帯電話、半導体の売上が増加いたしましたが、光伝送システムや大型サーバ、ストレージシステム等のプラットフォーム製品の売上が減少し、３兆5,564億円（前年度比5.4%減）となりました。営業利益は、事業構造改革による事業のスリム化及びコストダウン効果のほか、ＰＤＰの売上増加による損益改善により、1,608億円（同3.0倍）となりました。

b.欧州
　当連結会計年度の欧州における売上高は、ソフトウェア、サポートビジネスの売上が減少したほか、デスクトップパソコン向け小型磁気ディスク装置からの撤退の影響があり、5,249億円（前年度比11.3%減）となりました。営業利益は、事業構造改革及びコストダウンの効果のほか、ＡＤＳＬ機器等の売上増加による損益改善により、36億円（前年度は179億円の損失）と益転いたしました。

c.米州
　当連結会計年度の米州における売上高は、通信事業会社の設備投資抑制の影響を受け、光伝送システム等の売上が減少し、2,575億円（前年度比36.2%減）となりました。営業利益は、187億円の損失（前年度は574億円の損失）となり、依然、営業損失ではあるものの、事業構造改革及びコストダウンの効果により、損益が改善しております。

d.その他

当連結会計年度のアジアを含むその他の地域における売上高は、アジア市場における半導体、ＬＣＤ等の電子デバイス製品の売上が増加し、2,786億円（前年度比10.8%増）となりました。営業利益は、事業構造改革及びコストダウンの効果に加え、売上増加による損益改善により127億円（同2.2倍）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度に引き続いて事業構造改革を実施したことに加え、前年度の事業構造改善費用の現金支出の時期が一部、当年度にずれ込んだことにより1,177億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資額を減価償却費の範囲内で、成長分野に集中したことに加え、保有有価証券や固定資産の売却収入により、644億円となりました。

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年度は1,028億円のマイナスでしたが、当年度においては533億円のプラスとなりました。

また、当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、平成14年５月に転換社債型新株予約権付社債2,500億円を発行した一方で、社債、転換社債の償還、リース債務の返済等により672億円のマイナスとなりました。

なお、前年度のキャッシュ・フローと、当年度のキャッシュ・フローの比較は次のとおりです。

	平成13年度 （自　平成13年４月１日 至　平成14年３月31日） （億円）	平成14年度 （自　平成14年４月１日 至　平成15年３月31日） （億円）
(A) 営業キャッシュ・フロー	3,065	1,177
(B) 投資キャッシュ・フロー	△4,094	△644
(C) フリー・キャッシュ・フロー (A) + (B)	△1,028	533
(D) 財務キャッシュ・フロー	913	△672
(E) キャッシュ・フロー計 (C) + (D)	△115	△138

２【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

このため生産、受注及び販売の状況については、「１．業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績に関連付けて示しております。

３【対処すべき課題】

過去２年間にわたる事業構造改革による収益構造改善の結果、営業利益につきましては、前期から大幅に改善いたしました。今後、下記の課題に取り組むことにより、「お客様起点経営」を追求し、事業収益体質の強化をさらに進め、財務体質の改善を図ってまいります。

・事業収益体質の強化

高い収益を確保しているソフトウェア・サービスビジネスにつきましては、アプリケーションの開発生産性向上への取り組みを一層加速し収益性を向上するとともに、医療、製造／流通大手、市町村統合等の成長市場や、ＣＲＭ、ＥＲＰ、Ｅ-learning、モバイルといった成長分野へのパワーシフトを行い、ビジネスの拡大を図ってまいります。また、組織的にも、営業とＳＥが一体となり、お客様への対応のスピードアップを図るとともに、お客様担当ＳＥ制度などの導入により、長期的視点に立ってお客様の競争力強化を実現するソリューションを提供してまいります。

プラットフォームビジネスにつきましては、全社的に最新の３次元ＣＡＤなどに代表されるＩＴ技術をフル活用し、開発期間の短縮、品質向上、部品共通化を図るとともに、各工場でのオペレーション改善を最重要課題と

して取り組み、製品開発力、コスト競争力を高めてまいります。また、情報と通信の融合を一層進め、ユビキタスの時代をスピード感をもってリードしてまいります。

電子デバイスビジネスは、ロジックＩＣを軸とし、情報家電や携帯端末などの成長性の高い市場に経営資源を集中することで、収益体質の強化を図ってまいります。また、サーバ、ネットワーク製品等、ＩＴシステムの競争力強化のために、ＣＭＯＳ最先端テクノロジの開発を進めてまいります。

・財務体質の改善

財務体質につきましては、キャッシュ・フローを重視する経営により、早期に体質の改善を図ってまいります。本業の事業収益を伸ばすことを第一に目指し、それに加え、保有する資産を有効に活用することで株主資本の充実と有利子負債の圧縮を進め、財務体質の健全化を図ってまいります。

・その他の取り組み

当社は、高い信頼性を提供することを最優先課題の一つとしており、業務のすべての段階での製品及びサービスの品質向上を実現してまいります。

また、ネットワーク化が進むなかで、個人情報及び企業情報の保護やネットワーク・セキュリティを強化する必要性が一層高まっております。当社におきましては、お客様のセキュリティを高める製品やサービスの提供を拡充するとともに、社内におきましても情報管理や社内システムの強化、教育の実施など、先端ＩＴ企業としての積極的な取り組みを継続してまいります。

これらの課題を不断の努力を積み重ねることにより解決し、豊かで活力のあるネットワーク社会づくりに貢献できるグローバルな企業としてお客様や社会から信頼されるよう自己革新を一層図ってまいります。

４【経営上の重要な契約等】

(1) 相互技術援助契約

相手方	国名	契約製品	契約内容	契約期間
Infineon Technologies AG	ドイツ	半導体装置	特許実施権交換	平成４年12月29日から関係特許の有効期間中
Lucent Technologies Inc.	米国	情報処理組織	特許実施権交換	平成元年６月14日から関係特許の有効期間中
		半導体装置	特許実施権交換	昭和63年12月14日から関係特許の有効期間中
International Business Machines Corporation	米国	情報処理組織	特許実施権交換	平成８年10月23日から関係特許の有効期間中
Microsoft Corporation	米国	ソフトウェア	特許実施権交換	平成９年９月16日から関係特許の有効期間中
Texas Instruments Incorporated	米国	半導体装置及び集積回路	特許実施権交換	平成８年２月２日から平成17年12月31日まで
Intel Corporation	米国	半導体装置	特許実施権交換	平成10年６月５日から関係特許の有効期間中
Motorola,Inc.	米国	半導体装置	特許実施権交換	平成９年８月11日から関係特許の有効期間中
National Semiconductor Corporation	米国	半導体装置	特許実施権交換	平成11年８月23日から平成20年12月31日まで
Samsung Electronics Co.,Ltd.	韓国	半導体装置	特許実施権交換	平成14年１月１日から平成23年12月31日まで

（注）　上記の契約は、すべて当社を契約会社としたものであります。

(2) 合弁契約

契約会社名	相手方	国名	契約内容
富士通株式会社（当社）	Advanced Micro Devices,Inc.	米国	平成５年３月30日、左記会社との間で、国内に半導体（フラッシュメモリ及びＥＰＲＯＭ）の合弁の製造会社を設立する契約を締結いたしました（合弁会社名：富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ株式会社）。なお、本契約の他、半導体装置についての特許・ノウハウ実施権交換契約も併せて締結いたしました。
富士通株式会社（当社）	Alcatel Participations	フランス	平成12年９月４日、左記会社との間で、フランス及び国内に移動通信無線インフラ機器の合弁の開発会社を設立する契約を締結いたしました（合弁会社名：Evolium S.A.S.、Evolium France S.A.S.、エボリウム・ジャパン株式会社）。なお、本契約の他、移動通信無線インフラ機器についての特許・ノウハウ実施権交換契約も平成12年11月１日に締結いたしました。

(3) 特定融資枠契約

当社グループ（当社及び連結子会社）は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、特定融資枠（コミットメントライン）契約を締結しております。

詳細は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　⑤連結附属明細表　借入金等明細表」に記載しております。

5【研究開発活動】

当社グループ（当社及び連結子会社）は、最先端技術の開発、市場ニーズに合った高付加価値製品の開発を目指し、基礎から応用にわたる幅広い研究開発活動を通じて自主技術の創造を推進しております。

当連結会計年度における各セグメント別の主な研究内容及び研究開発費は次のとおりであります。なお、研究開発費については、下記のセグメント以外のその他のセグメントの研究開発費6,532百万円のほか、㈱富士通研究所をはじめ、各セグメントに配賦できない基礎研究費用等29,674百万円が含まれており、当連結会計年度の研究開発費の総額は285,735百万円であります。

a.ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス関係では、電子行政や電子商取引が社会に浸透し、セキュリティの高いシステムが求められるなかで、セキュリティ確保に不可欠な個人認証技術の開発を進めました。特に指紋、声紋、顔、手のひらなどの特徴から個人を識別するバイオメトリックス認証技術の研究を進め、この技術とＩＣカードを併用した個人認証技術を開発いたしました。この技術により電子行政システム等の利用者は個人情報をシステム内のサーバに登録することなく利用者の端末で認証を済ませることができるため、個人情報の保護と本人確認によるセキュリティの確保を両立させることが可能となります。

当セグメントに係る研究開発費は63,535百万円であります。

b.プラットフォーム

プラットフォーム関係では、次世代サーバ技術として企業内の複数のコンピュータを一体として機能させ、利用者がコンピュータの状態や性能を意識することなく、必要なときに必要なリソースを用いて大規模な計算を分散実行させるグリッド技術を実用化いたしました。大型サーバやオフィスで業務に使用されている各パソコンを常に監視・制御し、計算を割当てて処理させるグリッドミドルウェアＧＲＩＰ（Grid Innovation Platform）の開発により実現いたしました。企業のＩＴ投資コストの削減ニーズが高まるなか、この技術により製造業や金融業などの大規模な計算を必要とする分野では、企業内のリソースを有効に活用することが可能となります。

当セグメントに係る研究開発費は122,670百万円であります。

c.電子デバイス

電子デバイス関係では、今後の成長が見込まれ、当社も注力している第三世代携帯電話基地局向けに窒化ガリウムを用いた高出力増幅器を開発いたしました。従来の増幅器の動作可能電圧は、基地局のシステム電源電圧より低く、電源変換回路を必要としたため、電力損失によりシステムの効率が低下する問題がありました。増幅器に高電圧に耐えることのできる窒化ガリウムを使用することにより電力損失が少なく、システム効率の高い基地局を実現することが可能となります。

当セグメントに係る研究開発費は63,324百万円であります。